

# FUJIMI

in Micro Cosmos

株式会社フジミインコーポレーテッド  
株主通信・Vol.18（平成16年6月）  
（第52期事業報告）

## Marketing Strategy

フジミをけん引する  
営業の販売戦略について語る  
→P3~6

## 連結決算ハイライト

(単位：百万円、百万円未満は切り捨てています。)

	第50期	第51期	第52期
	平成14年3月31日現在	平成15年3月31日現在	平成16年3月31日現在
売上高	18,945	21,992	<b>23,938</b>
営業利益	274	2,177	<b>3,007</b>
経常利益	284	2,147	<b>2,981</b>
当期純利益	△ 315	1,086	<b>1,922</b>
総資産	41,032	42,167	<b>40,990</b>
株主資本	35,314	34,775	<b>35,068</b>
一株当たり当期純利益 (円)	△ 20.43	68.39	<b>125.21</b>
一株当たり株主資本 (円)	2,300.78	2,307.60	<b>2,371.68</b>
株主資本当期純利益率 (%)	△ 0.9	3.1	<b>5.5</b>
総資産当期純利益率 (%)	△ 0.7	2.6	<b>4.6</b>
株主資本比率 (%)	86.1	82.5	<b>85.6</b>
一株当たり配当額 (フジインコーポレーテッド単体)	30.00円	30.00円	<b>32.00円</b>

## 平成15年度(第52期)連結決算のポイント

●パソコン出荷台数の伸びやカメラ付携帯電話への買替需要の増大、デジタル家電製品の販売拡大により、半導体市場全体が堅調に推移したことから、当社の売上高全体は239.3億円となり、前期比8.9%増を達成しました。特に、CMPスラリーはデザインルールの微細化・多層配線化といった市場ニーズに応え、収益増の牽引役となりました。また、半導体ウェハー向け製品も高付加価値品であるポリシング材が売上げを伸ばし、シリコン切断用のワイヤーソー向け製品も2ケタの伸びとなりました。

た。一方、ディスク向けおよび水晶向け製品につきましては市場環境の好転にもかかわらず競争激化により前年の水準を割込む結果となりました。

●営業経費面では、売上原価率の改善(前期比0.6ポイント減)と営業コスト削減により、営業利益、経常利益はそれぞれ前期比38.1%、38.8%の増加となりました。当期純利益は77.0%増の19.2億円となりました。

●株主資本当期純利益率は、前期の

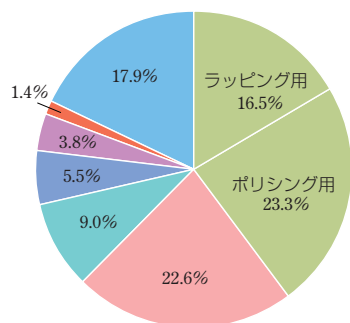
3.1%から当期は5.5%となりました。

●1株当たり当期純利益は、125円21銭となりました。配当金は、1円増配の1株16円とさせていただきました。年間では1株当たり2円増配の32円の配当となります。

●設備投資額は、20.2億円であり、各務原工場CMP設備および検査機器購入のほか、米国子会社フジコーポレーションのCMP増産設備および研究開発設備などが主な内容です。なお、設備投資資金については、自己資金により充当しています。

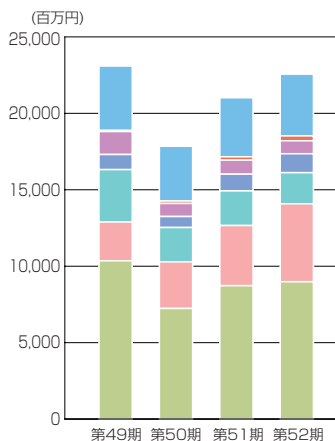
## 主要用途別製品売上高の特徴（連結）

第52期  
主要用途別製品売上高構成比



- 半導体ウェハー向け製品
- CMPスラリー
- ディスク向け製品
- ワイヤーソー向け砥粒
- 水晶デバイス研磨用
- 溶射材
- その他

用途別製品売上高の推移



※グラフは商品を含めない自社製品  
のみの売上高です。

### 半導体ウェハー向け製品

パソコンを中心に、OA機器やAV製品など、電子産業関連機器類の心臓部に使用されている半導体素子。この半導体素子を製造するには、シリコンウェハーに代表される半導体基盤を高精度に鏡面研磨しなければなりません。フジミのラッピング材、ポリシング材はこの分野で高いマーケットシェアを誇っています。

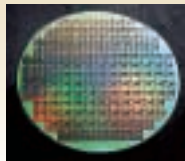


#### 売上高の特徴

半導体市場は、パソコンの需要回復、携帯電話端末の高機能化による出荷増、デジタル家電製品の普及により需要が拡大しました。当社の半導体ウェハー向け製品のうち、ラッピング材「FO」は単価下落や一部リサイクルの動きから売上高は弱含んだものの、高付加価値品であるポリシング材「GLANZOX」は売上を伸ばし、半導体ウェハー向け製品全体では、売上高89.6億円（前期比3.0%増）となりました。

### CMPスラリー

半導体の集積度を上げるために半導体チップ上の多層配線の重要性が高まり、この多層化のための必須技術として実用されているのがCMP（化学的機械的平坦化）。フジミのもつ長年にわたるシリコンウェハー用のファイナルポリシング材開発ノウハウが応用展開可能な事業で、高成長が期待される分野です。



#### 売上高の特徴

IT時代の進展に伴い、情報通信機器やエレクトロニクス製品の小型化とともに高機能化・高性能化が急速に進み、半導体デバイスについてもさらなる高集積化・多層配線化が要求されています。当社のCMPスラリー「PLANERLITE」は、その品質特性からユーザーの採用が拡大し、売上高は50.9億円（前期比29.6%増）と順調な伸びを示しました。

### ディスク向け製品

パソコンの高機能化に伴い、プログラムやデータの高速読み出しが可能な小型・大容量メモリーのハードディスクが注目を集めています。このため、ディスク研磨についても、より高精度な水準が要求されるようになりました。フジミはこの分野でも世界的に高い評価を得ています。



#### 売上高の特徴

パソコン市場は、IT促進税制等を背景に法人向けが復調し、加えてインターネットのインフラが整備され高機能パソコンが低価格で市場投入されたことにより個人の買替需要が増大しました。また、DVDレコーダーに代表されるデジタル家電にもHDDの搭載が進み、ハードディスクの需要は堅調に推移しました。しかしながら、市場拡大とともに製品開発競争や価格競争が激化したため、ガラスディスク向け製品は売上増となったものの、アルミディスク向け製品が苦戦しディスク向け製品全体の売上は前年を割込む結果となり、売上高は20.3億円（前期比10.4%減）となりました。

### ワイヤーソー向け砥粒以下その他売上高の特徴

シリコン切断に使われるワイヤーソー向け砥粒は、特に太陽電池の市場拡大を受け、この分野向けの製品が当初計画を上回ったことにより、全体の売上高は12.3億円（前期比13.7%増）と好調でした。水晶業界は、高機能携帯への買替需要や自動車の電装化の進展により市場は拡大したものの、水晶デバイスの小型化による消耗材の使用量減や中国製品の流入による単価下落により、水晶デバイス研磨用の売上高は、8.4億円（前期比7.5%減）となりました。新規事業であります溶射材については、積極的な営業活動と技術支援活動が実を結び、サーメット溶射材の伸びが堅調となり、売上高は3.1億円（前期比42.2%増）と大幅に増加しました。



## フジミをけん引する 営業の販売戦略について語る

—松島伸男取締役営業本部長—

### ■松島取締役の略歴■

1984年 4月 不二見研磨材販売株式会社入社、国内営業を担当

1999年 4月 経営企画室長

2001年 6月 取締役経営企画室長

2002年 4月 取締役営業本部長

**CMP（化学的機械的平坦化）：**  
配線の構造上、多層配線（垂直方向に配線を複数積み重ね、立体的な配線構造をつくる技術）において、電子回路の表面の凹凸を平坦化する技術。砥粒を用いた機械的研磨と化学作用を複合させたポリシングで、主な加工対象には配線や層間絶縁膜がある。これらに用いられる研磨材をCMPスラリーという。

**水晶デバイス：**周波数制御・選択用電子部品として周波数の安定度、秩序および通信の質を守るために情報端末機器、携帯端末、デジタルカメラ、コードレスホンなどの、日常に密着した機器に幅広く使用されている部材。

### フジミにおける営業本部の役割

**Q** 開発型製造企業であるフジミにおける営業本部の役割を聞かせてください。

**松島** フジミにおける営業の役割は大きく分けて3つあります。1つめは「お客様のニーズとフジミを結び、お客様のご満足（CS）につなげる」こと。2つめは「売上拡大とシェア向上を図る」こと。そして、3つめは「市場のトレンドをつかみ、社内の開発や生産と連携する」ことです。

こうした役割を担うには、まず、お客様のニーズを正しく把握し、開発や生産など社内との関係する部署に正確に伝える能力が求められます。私たちの一次情報が誤っていると、社内のミスリードにつながるだけでなく、結果としてお客様のご満足に結びつきません。もちろん、売上の拡大やシェア向上にもつながりません。お客様のニーズを正しく吸い上げることが最も大切です。

**Q** フジミの製品は先端の技術分野で使用されるものですが、営業にはどのような資質を求めていますか。

**松島** お客様の事業に対する深い知識があれば申し分ありませんが、かならずしも理工系の出身者である必要はないと思います。開発とか生産などを経験し、社内のローテーションを経て営業に来るのが理想的ですが、お客様のニーズを迅速に捉える必要から、実際は中途採用で即戦力として採用されるケースも少なくありません。

また、実際には技術担当者と同行するケースもありますので、そうした機会を経て、製品に対する知識やお客様のニーズを正しく把握できる力を蓄えることが大切です。

その上で、企業の収益の源泉である売上を伸ばすために、外に向けてアグレッシブに行動することでしょうか。最も望ましい資質は、拡大志向を持ち、お客様のお役に立ちたいという気持ちだと思います。

## 市場と需要の拡大に向けて

### Q | フジミの主要製品の用途とその市場分野についても紹介ください。

松島 用途別で見ますと、シリコンウェハー向け、\*CMP向け、ハードディスク向け、\*水晶デバイス向けなどがあります。

### Q | 一般の株主にはなかなか理解が難しいのですが、シリコンウェハー向けとは。

松島 シリコン単結晶を薄い円盤状に加工したものが半導体シリコンウェハーです。このシリコンウェハーの表面に半導体素子を形成させるわけですが、そのためには表面を高精度に磨かなければなりません。この研磨用の材料が当社の\*ラッピング材です。それをさらに鏡面に高精度仕上げを行うものを\*ポリシング材と呼んでいます。シリコンウェハー向けは当社売上の約40%を占めています。

### Q | CMP向けスラリーとはどのような用途に使われるものですか。

松島 ICチップの集積度を高める方法の1つとして注目されているのが電子回路の多層配線です。半導体ウェハー上に電子回路と\*絶縁膜を交互に積み上げます。このとき問題なのが、半導体素子表面にできる凹凸による段差です。これによって配線層の断線が起きたり、配線層間の絶縁不良が発生する可能性があるため、CMPによる平坦化が必要になりました。CMPスラリーはこの平坦化に用いられる研磨材です。この数年、順調にシェアを高め、現在は当社売上の約20%を占めるようになっています。

### Q | ハードディスク向けとはどのような用途のものですか。

松島 パソコンやサーバー、さらに最近ではDVDレコーダーなどに記憶装置として搭載されているのが\*ハードディスクドライブ(HDD)です。この装置の情報を蓄える部分がハードディスクと呼ばれる磁気ディスクで、アルミ基板とガラス基板の2つの素材に分かれます。この研磨にも当社製品が用いられています。売上に占める比率は約10%となっています。

### Q | これ以外にはどのような用途の製品がありますか。

松島 シリコンウェハーや\*ソーラーセルの切断に使用されるワイヤーソー向け砥粒、携帯電話や各種電気製品に組み込まれている水晶振動子を加工する際に用いられる水晶デバイス用砥粒、さまざまな分野の表面改質に使用される\*溶射材などがあります。

### Q | お客様が製品を選ぶ際の基準はどのようなものですか。

松島 価格も重要な要素の1つですが、お客様はそれだけで判断するわけではありません。品質の優れた製品を採用することで、お客様が生産する製品への評価が高まれば、お客様ご自身の販売先に対してもシェアが取れるからです。つまり、価格・品質両面でお客様ご自身が製品の差別化ができるかどうかを選択の基準ではないでしょうか。

### Q | 分野別シェアと今後の販売目標についてお聞かせください。

松島 半導体ウェハー向けラッピング材は、現在90%のシェアがあります。競合メーカーと棲み分けができていの中で残りの10%を取るのはいかなりのエネルギーが必要です。半導体ウェハー向け一次・二次のポリシング材は、推定で10%程度のシェアですが、これは50%にもっていきたいと考えています。この分野は、ウェハーの大口径化に伴い、お客様のポリシング

ラッピング材：工作面を極めて精密な平面に仕上げるために使用される研磨材。

ポリシング材：加工面を精密な鏡面に仕上げるために使用される、薬品添加された研磨材。

絶縁膜：絶縁体（電気や熱を通しにくい物体・物質）からなる膜。ICでは半導体素子や配線各部を電氣的に絶縁するために用いられる。

ハードディスクドライブ(HDD)：コンピュータなどに使用される記憶装置。

ソーラーセル：0.2~0.3mmという薄さで、太陽の光を受け電気エネルギーに転換させるシリコン結晶体。

溶射材：素材を熱や摩擦・腐食から守るために、溶射材料を熱で溶かしながら吹き付け、素材をコーティングする技術を溶射といい、それに使われる材料（主に金属とセラミックス）を溶射材という。

**超高純度コロイダルシリカ**：シリカ（二酸化珪素）の微細粒子が水などの溶媒に分散された状態のものをコロイダルシリカといい、粒子径は通常10～30ナノメートル程度で、コロイド状に分散した状態であるためコロイダルシリカと呼ばれる。超高純度コロイダルシリカは不純物が少なく粒子の均一性や分散性に優れ、品質の安定性が高いなどの優位性があり、これを用いたフジミのシリコンウェハのファイナルポリシング材はトップシェアを誇る。また、超高純度コロイダルシリカタイプのCMPスラリーも市場の好評価を得ている。

**デバイス**：ここでは半導体を搭載した超小型電子部品・電子装置をさす。情報を記憶するメモリやコンピュータの頭脳にあたる論理回路（MPU）、これらをチップ1個で実現したシステムLSIなどが代表的。

**デザインルール**：LSI（大規模集積回路）の最小加工長。LSI上の素子の中でもっとも小さく作られている部分の長さのことをいう。現在は65～90nm（ナノメートル。1nm＝10億分の1メートル）あたりが開発の対象となっている。

**LD（レーザーダイオード）**：半導体を媒体としているレーザーのこと。LDは電気を流すことによりレーザー光を発振させることができ、通信や光ディスクの光源として使用されている。

材に対する要求品質も厳しくなっています。**\*超高純度コロイダルシリカを使った付加価値の高い製品により、目標を達成したいと考えています。すでに幾つかの商談で確かな手ごたえをいただいています。**

## Q | 半導体ウェハー向けにはファイナルのポリシング材もありますね。

**松島** 現状でシェアが80%と高い状況ですが、あと10%程度は上げたいと考えています。これに関しても先ほど述べました一次・二次ポリシング材と同様、ウェハーの大口径化に伴う要求品質の高度化に 대응するという目標が明確ですので、技術ならびに営業の力をそこに集中できればシェア90%も不可能ではないと思います。

## Q | ディスク向けについても聞かせてください。

**松島** アルミディスク向け一次ポリシング材は、一時80%のシェアがありましたが、直近では65%に落ち込んでいます。まずはもとの80%に戻すのが目標です。ディスクの世界でもまず品質が重視されます。それに価格がついてくるという関係です。両者はいわば車の両輪です。見かけの価格が高くても、品質のよいディスクができればコストパフォーマンスのよい研磨材との評価を受けるわけです。

一方でアルミディスク向けファイナルポリシング材は、現在10%弱までシェアを落としています。ライバル企業が品質の良いものを出してきたことによるものです。4～5年前にさかのぼれば、当社が80%のシェアをもっていた分野だけに、なんとしても50%奪取しなければならぬと考えています。

## Q | 溶射材など新分野への営業はどのように行われているのでしょうか。

**松島** 溶射材については、昨年、溶射材事業部を設立しました。お蔭様で2ケタ成長を続けて

います。用途としては、研磨材ではない新しいパウダー用途であることから当社の事業範囲のさらなる展開に寄与するものと期待をしています。新しい分野への営業については昨年、戦略事業部を設立し、将来の事業の可能性をあらゆる角度から調査・分析しています。面白い案件も出てきつつあります。

## 市場の変化を読む

## Q | 変化の激しい分野がお客様だけに、新しい技術動向をつかむのも大きな課題では。

**松島** 一次情報としてのお客様の生の声が最も重要と考えています。その他の手段として業界紙や当社新規事業本部の情報です。新規事業本部の傘下にあるCMP事業部は、チップメーカーと取引していますから、\*デバイスの技術情報に直接触れることができる立場にあります。それらと照らし合わせることで、大きな技術トレンドがつかめます。たとえば、\*デザインルールの微細化に伴い、ウェハーメーカーではパーティクル（結晶起因、微小な粒子の集まりなどの付着物）の低減や、金属不純物の低減、極限までの平坦化が要求されています。このようなことは研磨材やスラリーでもある程度の解決が可能だけに、当社への期待もおのずと明確になってきます。

## Q | CMP関連の売上が好調と聞いていますが、今後、この市場がどのように展開していくとお考えでしょうか。

**松島** CMP好調の背景には多層配線化と微細化があります。現在、ロジック系の集積回路では8～9層、130nmが主流になりつつありますが、すでに90nmの量産も開始されており、今後配線の微細化が進むにつれ、さらに多層配線化が進むものと期待されています。CMP分野の市場規模はここ数年2ケタ成長を続けてお

り、2003年度で約500億円、2006年度には750億円程度まで成長すると考えられています。

## Q | デジタル家電が好調ですが、これらの分野との関連は。

松島 ハードディスクの新用途として期待できるものにDVDレコーダーがあります。ハードディスクの用途としては、パソコンやサーバー以外の比率がまだ10%程度ですが、DVDレコーダーに搭載されていけば、さらに拡大できると期待しています。また、デジタルカメラや携帯電話などにも1インチ前後のマイクロドライブが搭載されていくと聞いており、そうなればディスク用スラリーの拡大が見込めます。

DVDレコーダーは、レーザーで情報を読み取っていますが、\*LD(レーザーダイオード)や\*LED(発光ダイオード)の基板となる\*ガリウム砒素(GaAs)や\*ガリウム燐(GaP)を磨く研磨材も出しています。LEDは、携帯電話の画面のバックライトとしても使われています。携帯電話やDVDレコーダーなどには水晶発振子といわれる水晶デバイスも使われていますので、この2つが伸びれば、水晶用の研磨材も伸びが期待できます。

## グローバル市場戦略と海外展開

## Q | 小さなグローバル企業と呼ばれるフジミは、海外のお客様が占める比重も高いようですね。

松島 当社のお客様がアジア・北米・欧州に進出されるようになり、それを支える形で海外に進出しました。海外拠点としては、北米にフジミコーポレーション(米国)、欧州にフジミヨーロッパ(英国およびドイツ)、アジアにフジミマイクロテクノロジー(マレーシア)を置いております。これらの地域については、各拠点と本社が連携を取りながら営業を行っています。

中国は、駐在員をおいてマーケティングを行っている段階です。

## Q | 中国は期待できそうですか。

松島 日本などから中国に進出されているお客様にはすでに当社品をお使いいただいています。中国の地場のメーカーや台湾・韓国から進出しているメーカーについてはこれからです。中国のシリコンウェハーメーカーで8インチまで作っているのは1社だけです。それ以外は2~4インチといった小口径が圧倒的に多い状況です。現状は、中国産の安価な研磨材を使っているということはわかっています。そうしたお客様にフジミの製品をどうやってご理解いただくかが重要な課題です。見掛けの価格は少し高いけれども品質が良いので、結局はお客様の製品歩留まりがよくなり、全体としてはコスト低減が図れるということをどのようにPRするかだと思います。

当社の海外向け販売は全体の45%ですが、今後も海外のお客様のご要望にダイレクトに対応できるようにしたいと考えています。

## 全社目標と営業の課題

## Q | ROE10%などの全社目標に対し、営業本部はどのような役割を担い、成果に結びつけようとしていますか。

松島 ROE10%という全社目標を達成するためにRの源泉である売上を伸ばすことが大使命です。営業本部としては、売上計画を達成することに最大の力を注がなければなりません。一方でスリム化という意味で、製品在庫回転率を上げていくことも重視しています。当社が関わっている電子材料の市場はたえず需要が変化していますので、売れ筋製品の適正な在庫を維持しつつ、売上の機会損失が生じないようにしなければなりません。



**LED(発光ダイオード)**：半導体部品のうち電流を片方向のみ流すものをダイオードといい、そのうちのLEDは電流を順方向(マイナスからプラス)に流した時に光るダイオード。

**ガリウム砒素(GaAs)**：ガリウム(Ga)と砒素(As)を材料とする半導体素材でガリウム砒素(GaAs)を利用したものはシリコン(Si)よりも高速で動作し、消費電力も約3分の1と少ない。また小型化が容易という特徴がある。ただし、ガリウム砒素(GaAs)はシリコン(Si)に比べ高価で、純度の高いガリウム砒素(GaAs)を得ることもシリコン(Si)より難しい。

**ガリウム燐(GaP)**：ガリウム(Ga)と燐(P)を材料とする半導体素材で主にガリウム砒素(GaAs)同様に高価であり、主にガリウム燐(GaP)・ガリウム砒素(GaAs)等の化合物半導体は発光素子に使われる。

## 株主の皆様へ

### ●前期を上回る業績を達成

わが国経済は、輸出を中心とした景気の拡大と、旺盛なデジタル機器関連需要に支えられ、事業環境は回復基調を強めることとなりました。情報通信関連業界におきましては、高速ネットワークインフラの整備、インターネット普及率の上昇とともに、デジタル家電製品の販売が急速に増大し、市場の拡大がみられました。

このような市場環境下、半導体出荷額も大きく伸びたことから、当社のシリコンウェハー向けポリシング材、半導体の多層配線工程に使用されるCMP（化学的機械的平坦化）向け製品、半導体および太陽電池用シリコンの切断に用いられるワイヤーソー向け製品、溶射材等は順調に売上を伸ばすことができました。

一方、ハードディスク用ポリシング材と水晶デバイス向け製品は減少いたしました。ハードディスク用ポリシング材は開発競争や価格競争の激化による単価下落が、水晶デバイス向け製品は部品の小型化・薄型化による研磨材の消費量減少が主な要因です。

### ●競争力を高めるために

第52期は、年度のスローガンとして「革新への挑戦」を掲げるとともに、株主資本当期純利益率（ROE）5.0%以上の達成を目標に取り組んでまいりました。月次ベースでは目標を下回る月もありましたが、最終的には5.5%となりました。売上計画の達成に加えて、製造原価や販売管理費の低減に向けた取り組みが功を奏したものとされます。

また、下期の取り組みに稲沢工場におけるVPM（生産価値改善）活動の導入を行いました。従業員一人当たりの生産性が対上期比で22%改善するまでに

至りました。

新しい試みであっただけに、この成果を踏まえ、今後の全社の生産価値改善の活動につなげてまいりたいと考えています。

なお、株主様に対する利益還元は1株当たり年間2円増配の32円（中間期配当16円）とさせていただきます。



代表取締役社長 越山 彰

### ●第53期に向けて

経済は先行き不透明ながら、概ね堅調な拡大が予想されています。

第53期、当社は前期に引き続き「革新への挑戦」を年度スローガンに掲げました。原価低減ならびに生産性を高め、収益性向上に努めるとともに、競争の激しい市場で優位性を堅持するために、既存の分野においてこれまで以上に高い品質と安定的な供給そして迅速な開発レスポンスとサービスを提供してまいります。また、CMPや溶射材分野をはじめとする、新規事業・新用途の開拓および育成にも積極的に取り組んでまいります。

引き続き、株主の皆様のご支援をお願い申し上げます。

平成16年6月

代表取締役社長

越山 彰

### インテル社から「サプライヤー・コンティニュアス・クォリティー・インプローブメント (SCQI)」賞を初受賞

米国子会社であるフジミコーポレーション(本社:米国オレゴン州)は、このほど世界的な大手半導体メーカーであるインテル社から最高位の賞である、「2003年サプライヤー・コンティニュアス・クォリティー・インプローブメント (SCQI)」賞を受賞しました。同社は、インテル社にICの多層配線面の平坦化に用いられるCMPスラリーを供給しており、過去において2年連続で「プリファード・クォリティー・サプライヤー (PQS)」賞に選ばれた実績があります。SCQI賞はインテル社の原材料供給者継続改善プログラムの一環として、コスト、品質、供給能力、技術の各分野において95点以上の高スコアを獲得した企業が受賞対象となります。当社としても今回の受賞を荣誉あるものと受け止めています。



### 米国にR&Dセンターを開設

米国拠点であるフジミコーポレーションは、このほどCMPスラリーの開発を主目的とした新R&Dセンターを開設しました。米国における開発業務は、1994年のディスク関連技術サービスを皮切りにスタートし、CMPスラリーについては本社開発部門の協力を得て行われてきました。同センターは、クリーンルームの中に分析や試験に必要な機器設備を有しており、本社開発センターと同等のCMPスラリーの開発業務が行えます。今後はこれまでの蓄積された技術と経験を土台に、北米ユーザーに密着したCMPスラリーの新規商品開発・技術サービスに努めます。

### セミコン・チャイナに出展

市場拡大が期待される中国で、今年も3月17日(水)~19日(金)の3日間、「セミコン・チャイナ2004」が上海浦東地区の会場で開催されました。3度目の出展となった当社ブースには、日本、中国、台湾、韓国から多数の来訪者がありました。世界各国からの参加企業数は845社になり、セミコン・ジャパンの半分の規模に達しています。当社もこの有望な新市場“中国”で駐在員を配置し、マーケット開拓に努めています。写真にあります「福吉米」は、当社の漢字圏における社名で「フジミ」と読みます。



### ホームページをリニューアル

ホームページをリニューアルいたしました。株主の皆様をはじめ当社のさまざまなステークホルダーの皆様へ、親しみがあり分かり易い内容となるように、新たに環境への取り組みや倫理綱領などの項目、技術情報の項目を追加するなど、デザイン・内容ともに一新いたしました。今後とも継続的に改善に努めてまいります。ご期待ください。

## 連結貸借対照表

(単位：百万円、百万円未満は切り捨てています。)

### 流動資産

長期預金等への振替により現預金が減少し、**流動資産**は前期末比16.7億円減少しました。

### 固定資産

当期の**設備投資**は、各務原工場および本社工場設備のほかフジミコーポレーション研究設備などにより16.0億円となりました。減価償却費は20.2億円となり**有形固定資産**は前期末比6.7億円の減少となりました。**無形固定資産**は償却が進み、0.6億円減少しました。**投資その他の資産**は、長期預金への振替を主な要因として12.3億円増加しました。

### 負債

**流動負債**は、前期末比10.4億円減少しました。未払法人税等の減少によるものです。**固定負債**は、役員退職引当金の取崩しにより4.2億円の減少となりました。

### 株主資本

自己株式の取得はあったものの、利益の内部留保により、**株主資本**は2.9億円増加しました。**株主資本比率**は3.1ポイント増の85.6%となりました。

	第50期 平成14年3月31日現在	第51期 平成15年3月31日現在	第52期 平成16年3月31日現在
<b>資産の部</b>			
流動資産	21,669	23,944	<b>22,273</b>
現金及び預金	7,312	13,291	<b>10,869</b>
受取手形及び売掛金	5,981	6,173	<b>7,345</b>
棚卸資産	3,403	3,384	<b>3,006</b>
短期貸付金	2,008	1	<b>1</b>
その他流動資産	2,982	1,126	<b>1,066</b>
(貸倒引当金)	△ 17	△ 33	△ <b>16</b>
固定資産	19,362	18,223	<b>18,717</b>
有形固定資産	16,912	15,614	<b>14,939</b>
無形固定資産	571	484	<b>417</b>
投資その他の資産	1,878	2,124	<b>3,360</b>
資産合計	41,032	42,167	<b>40,990</b>
<b>負債の部</b>			
流動負債	4,625	6,378	<b>5,334</b>
支払手形及び買掛金	2,281	2,629	<b>3,110</b>
短期借入金	1,359	697	<b>449</b>
その他流動負債	984	3,051	<b>1,774</b>
固定負債	1,060	983	<b>555</b>
負債合計	5,685	7,362	<b>5,889</b>
<b>少数株主持分</b>			
少数株主持分	32	29	<b>32</b>
<b>資本の部</b>			
資本金	4,753	—	—
資本準備金	5,038	—	—
連結剰余金	24,751	—	—
その他有価証券評価差額金	1	—	—
為替換算調整勘定	771	—	—
自己株式	△ 1	—	—
資本合計	35,314	—	—
資本金	—	4,753	<b>4,753</b>
資本剰余金	—	5,038	<b>5,038</b>
利益剰余金	—	25,394	<b>26,800</b>
その他有価証券評価差額金	—	△ 21	<b>80</b>
為替換算調整勘定	—	378	△ <b>75</b>
自己株式	—	△ 767	△ <b>1,529</b>
資本合計	—	34,775	<b>35,068</b>
負債及び資本合計	41,032	42,167	<b>40,990</b>

## 連結損益計算書

### 売上高

半導体ウェハー向け製品は、半導体出荷額が大きく伸びたことから売上高は増加し、半導体および太陽電池用シリコンの切断に用いられるワイヤーソー向け製品の売上高も大幅な伸びを示しました。CMPスラリーは、国内外のデバイスメーカーへの出荷が増大し売上高は急増しました。ハードディスク向けスラリーについては、パソコンの出荷増や民生用に搭載が進むなどハードディスクの需要枚数は増加したものの、製品開発競争や価格競争の激化により、当社のアルミディスク向け製品の売上高は減少しました。水晶向け製品については、携帯電話の出荷が拡大しましたが、部品の小型化・薄型化が進み、部品個数の伸びほどには研磨材の消費量は増加せず、単価下落の影響を受け売上高は減少しました。溶射材につきましては、積極的な営業活動と技術支援活動が実を結び、耐衝撃性、耐熱性、耐磨耗性に優れた性能を持つ「サーメット溶射材」の伸びが堅調となり、売上高は大幅に増加しました。また、商品売上につきましては、半導体関連の設備投資拡大に伴って研磨機の販売が伸び、売上高は増加しました。その結果、**総売上高**は前期比8.9%の増加となりました。

### 営業利益

売上の増加により**売上原価率**が0.6ポイント好転し、**販売費及び一般管理費**もコスト削減に努めた結果、**営業利益**は前期比38.1%の大幅な増加となりました。

### 経常利益・当期純利益

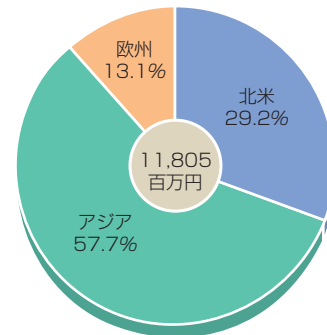
**営業外損益**では、急激な円高の影響を受けましたが、**売上高経常利益率**は2.7ポイント向上し、**経常利益**は38.8%増の29.8億円となりました。その結果、**当期純利益**は19.2億円となりました。また、**株主資本当期純利益率(ROE)**は、前期比2.4ポイント増の5.5%となりました。

(単位：百万円、百万円未満は切り捨てています。)

	第50期 平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで	第51期 平成14年4月1日から 平成15年3月31日まで	第52期 平成15年4月1日から 平成16年3月31日まで
<b>売上高</b>	18,945	21,992	<b>23,938</b>
売上原価	14,281	14,997	<b>16,191</b>
販売費及び一般管理費	4,389	4,816	<b>4,739</b>
<b>営業利益</b>	274	2,177	<b>3,007</b>
営業外収益	108	88	<b>90</b>
受取利息/配当金	41	51	<b>34</b>
その他	67	36	<b>56</b>
営業外費用	99	118	<b>116</b>
支払利息	56	47	<b>17</b>
有価証券売却損	32	—	<b>—</b>
その他	10	71	<b>98</b>
<b>経常利益</b>	284	2,147	<b>2,981</b>
特別利益	9	8	<b>169</b>
特別損失	641	270	<b>58</b>
<b>税引前当期純利益</b>	△ 347	1,885	<b>3,092</b>
法人税、住民税及び事業税	70	1,239	<b>780</b>
過年度法人税等	93	—	<b>—</b>
還付法人税等	△ 125	—	<b>—</b>
法人税等調整額	△ 76	△ 444	<b>383</b>
少数株主利益	5	4	<b>6</b>
<b>当期純利益</b>	△ 315	1,086	<b>1,922</b>

	(百万円 %)	
	第51期	第52期
海外売上高		
海外売上高 (連結売上高)	11,445 (21,992)	<b>11,805</b> <b>(23,938)</b>
海外売上高の 連結売上高に 占める割合	52.0	<b>49.3</b>

海外売上高構成比(第52期)



\*各区分に属する地域の内訳は次のとおりです。  
北米：米国、カナダ  
アジア：台湾、タイ、シンガポール、マレーシア、韓国、中国  
欧州：イギリス、デンマーク、ドイツ

## 連結キャッシュフロー計算書

(単位：百万円、百万円未満は切り捨てています。)

### 営業活動によるキャッシュフロー

営業活動の結果得られた資金は、24.9億円（前期比57.6%減）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が30.9億円（同64.1%増）計上されたものの、減価償却費が20.2億円（同12.0%減）と減少し、法人税等の支払額が18.4億円（同1,559.1%増）と大幅に増加したことに加え、売上債権の増加による資金の減少があったことによるものです。

### 投資活動によるキャッシュフロー

投資活動の結果使用した資金は30.0億円（前期比227.7%増）となりました。これは主に有形固定資産取得による支出18.7億円（同165.2%増）および長期預金への振替9.5億円によるものです。

### 財務活動によるキャッシュフロー

財務活動の結果使用した資金は14.1億円（前期比20.7%減）となりました。これは主に自己株式の取得（7.6億円）および親会社による配当金の支払額4.6億円によるものです。

現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益が30.9億円（前期比64.1%増）と増加したものの、売上債権の増加、長期預金への振替および自己株式の取得等の支出により、前連結会計年度末に比べ20.7億円減少しました。この結果、資金残高は114.1億円となりました。

	第50期 平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで	第51期 平成14年4月1日から 平成15年3月31日まで	第52期 平成15年4月1日から 平成16年3月31日まで
<b>営業活動によるキャッシュフロー</b>	2,332	5,871	<b>2,490</b>
税金等調整前当期純利益（損失）	△ 347	1,885	<b>3,092</b>
減価償却費	2,482	2,297	<b>2,020</b>
連結調整勘定償却額	163	163	—
売上債権増減額	2,977	△ 279	△ <b>1,268</b>
仕入債務増減額	△ 1,714	414	<b>571</b>
棚卸資産増減額	330	△ 105	<b>252</b>
その他	287	1,623	△ <b>351</b>
小計	4,180	5,999	<b>4,317</b>
利息及び配当金の受取額	41	30	<b>34</b>
法人税等の支払額	△ 2,143	△ 111	△ <b>1,843</b>
その他	254	△ 47	△ <b>17</b>
<b>投資活動によるキャッシュフロー</b>	△ 3,905	△ 918	△ <b>3,008</b>
定期預金の預入による支出	△ 500	△ 300	△ <b>950</b>
有価証券の取得による支出	△ 549	△ 99	—
有価証券の売却による収入	254	581	—
有形固定資産取得による支出	△ 2,749	△ 706	△ <b>1,872</b>
その他	△ 360	△ 393	△ <b>186</b>
<b>財務活動によるキャッシュフロー</b>	△ 1,227	△ 1,782	△ <b>1,413</b>
短期借入金の純増加（減少）額	256	△ 572	△ <b>185</b>
長期借入金の返済による支出	△ 437	—	—
自己株式の取得による支出	△ 542	△ 766	△ <b>761</b>
配当金の支払	△ 504	△ 443	△ <b>466</b>
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	40	△ 82	△ <b>139</b>
<b>現金及び現金同等物の増加（減少）額</b>	△ 2,760	3,089	△ <b>2,071</b>
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	90	—	—
<b>現金及び現金同等物期首残高</b>	13,072	10,402	<b>13,491</b>
<b>現金及び現金同等物期末残高</b>	10,402	13,491	<b>11,419</b>

## 単体決算の概要

(単位：百万円、百万円未満は切り捨てています。)

### ◇損益計算書

	第50期 平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで	第51期 平成14年4月1日から 平成15年3月31日まで	第52期 平成15年4月1日から 平成16年3月31日まで
<b>売上高</b>	15,207	18,684	<b>20,754</b>
売上原価	10,982	12,762	<b>14,162</b>
販売費及び一般管理費	3,514	3,774	<b>3,832</b>
<b>営業利益</b>	709	2,147	<b>2,758</b>
営業外収益	86	134	<b>125</b>
営業外費用	50	29	<b>81</b>
<b>経常利益</b>	745	2,252	<b>2,802</b>
特別損益	△ 599	△ 262	<b>111</b>
<b>税引前当期純利益</b>	146	1,989	<b>2,913</b>
法人税、住民税及び事業税	63	1,197	<b>736</b>
法人税等調整額	△ 32	△ 413	<b>389</b>
<b>当期純利益</b>	115	1,205	<b>1,787</b>
前期繰越利益	1,276	395	<b>1,100</b>
自己株式消却額	535	—	<b>—</b>
中間配当額	230	225	<b>240</b>
<b>当期末処分利益金</b>	625	1,375	<b>2,646</b>

### ◇貸借対照表

	第50期 平成14年3月31日現在	第51期 平成15年3月31日現在	第52期 平成16年3月31日現在
<b>資産の部</b>			
流動資産	18,596	21,374	<b>20,015</b>
固定資産	19,308	18,698	<b>19,431</b>
<b>資産合計</b>	<b>37,905</b>	<b>40,073</b>	<b>39,446</b>
<b>負債・資本の部</b>			
流動負債	3,165	5,401	<b>4,555</b>
固定負債	969	940	<b>548</b>
<b>負債合計</b>	<b>4,134</b>	<b>6,342</b>	<b>5,104</b>
資本金	4,753	—	<b>—</b>
法定準備金	5,401	—	<b>—</b>
剰余金	23,615	—	<b>—</b>
その他有価証券評価差額金	1	—	<b>—</b>
自己株式	△ 1	—	<b>—</b>
<b>資本合計</b>	<b>33,770</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
資本金	—	4,753	<b>4,753</b>
資本剰余金	—	5,038	<b>5,038</b>
利益剰余金	—	24,728	<b>25,999</b>
その他有価証券評価差額金	—	△ 21	<b>80</b>
自己株式	—	△ 767	<b>△ 1,529</b>
<b>資本合計</b>	<b>—</b>	<b>33,731</b>	<b>34,342</b>
<b>負債及び資本合計</b>	<b>37,905</b>	<b>40,073</b>	<b>39,446</b>

### 配当政策・株主配当金

当社は、株主に対する適正な利益還元を行うことを経営の重要課題と認識し、利益配分につきましては安定的な配当の継続を基本としています。内部留保金につきましては、今後の生産設備・研究開発投資等の経営基盤の強化ならびに事業展開に役立てたいと考えています。

このような方針のもと、当期末配当につきましては1株につき16円とさせていただきます。この結果、中間配当を含めた当期の配当金は、1株につき32円となります。

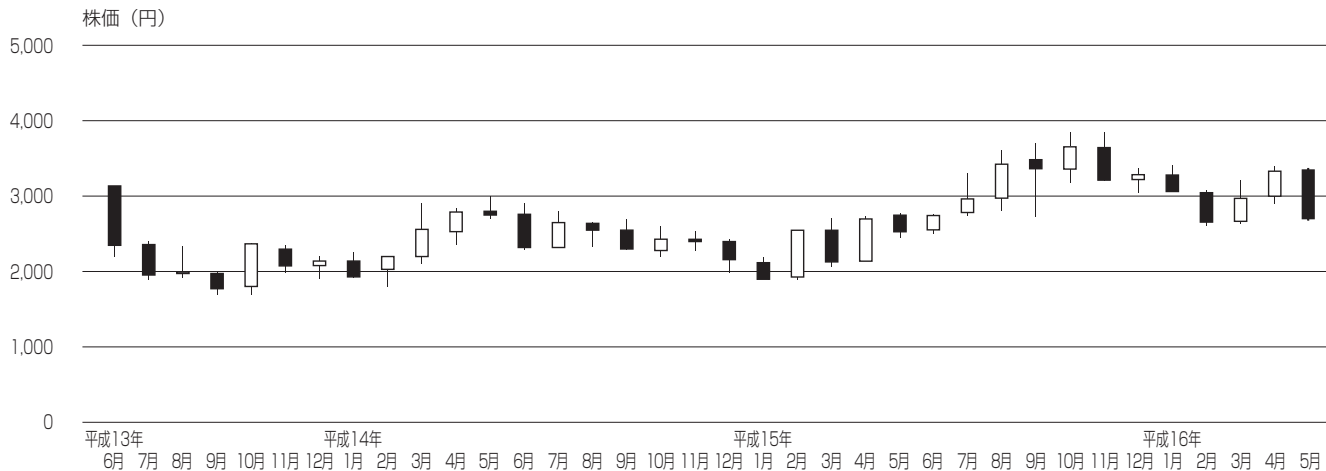
#### 利益処分

(単位：百万円)

	第52期
当期末処分利益金	2,646
配当金	236
役員賞与金	40
次期繰越利益金	2,370

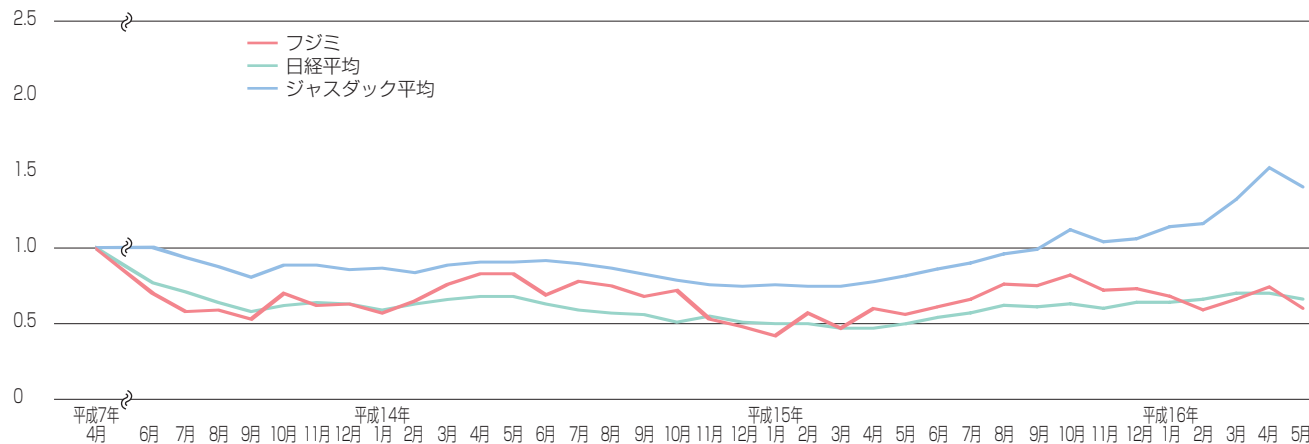
(注) 平成15年12月10日に240百万円(1株につき16円00銭)の中間配当を実施しております。

## 株価の推移



\* 株価データは、株式分割を過年度に遡及して調整した修正株価を使用しています。

## 株価の推移比較（フジミ・日経平均・ジャスダック平均）



\* 毎月の終値を、フジミが店頭公開した平成7年4月の株価（4月の終値）を1として指数化しています。フジミの株価が市場全体の動きに比べて、どのように変動しているかを示しています。

## 会社データ (平成16年3月31日現在)

### 商 号

株式会社フジミンコーポレートッド

### 証 券 コ ー ド

5 3 8 4

### 本 社 所 在 地

愛知県西春日井郡西枇杷島町地領2丁目1番地の1  
TEL. 052-503-8181 (代表)

### 設 立 年 月 日

昭和28年3月20日

### 資 本 金

4,753,438,500円

### 代 表 者

代表取締役社長 越山 彰

### 従 業 員

355名

## 役員 (平成16年6月24日現在)

代表取締役社長	越 山 彰
常務取締役	永 利 正
取締役	久 保 昌 昭
取締役	児 玉 一 志
取締役	中 川 博 行
取締役	松 島 伸 男
取締役	関 敬 史
常勤監査役	藤 本 俊 之
常勤監査役	野 田 純 孝
監 査 役	鮎 澤 多 俊
監 査 役	山 下 紀 雄

## 株主メモ (平成16年3月31日現在)

### 株式の状況

#### 株式数

会社が発行する株式の総数	39,747,300株
発行済株式総数	15,349,750株
株主数	5,327名

### 大株主

株主名	持株数	持株比率
越 山 勇	1,656,155株	10.8%
野 田 純 孝	1,420,000	9.3
有限会社コ マ	819,180	5.3
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	614,400	4.0
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	599,400	3.9
株式会社フジミンコーポレートッド	580,524	3.8
越 山 彰	570,700	3.7
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー	451,849	2.9
株式会社りそな銀行	445,892	2.9
日本生命保険相互会社	389,940	2.5

### 決算期

3月31日

### 基準日

3月31日

### 1単元の株式の数

100株

### 公告掲載新聞

日本経済新聞

### 名義書換代理人

東京都中央区日本橋茅場町  
1丁目2番4号

日本証券代行株式会社  
本店および各支店

### 同事務取扱場所

名古屋市中区栄  
3丁目3番17号  
名古屋証券会館5階

日本証券代行株式会社  
名古屋支店

### 同取次所

日本証券代行株式会社  
本店および各支店

技術を磨き、心をつなぐ

**FUJIMI**

FUJIMI INCORPORATED

**株式会社フジミインコーポレーテッド**

お問い合わせ先：経営企画室企画課

TEL：052-503-8181（代表）

ホームページアドレス：<http://www.fujimiinc.co.jp>